

英飞凌第三代高速开关 IGBT 系列

采用 Highspeed3 技术的低开关损耗 IGBT

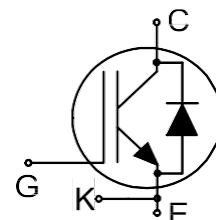
与软、快速恢复全额定电流反并联 EC 二极管共封装

特性：

高速 H3 技术提供：

- 采用开尔文发射极引脚封装并结合高速 H3 技术，实现超低开关损耗
- 展现在硬开关和谐振拓扑中的高效率
- $T_{vj}=175^{\circ}\text{C}$ 时短路耐受时间为 $10\mu\text{sec}$
- 由于 $V_{CE(sat)}$ 具有正温度系数，因此易于并联
- 低电磁干扰
- 低栅极电荷 Q_G
- 非常软、快速恢复的全电流反并联二极管
- 最高结温 175°C
- 无铅镀层；符合 RoHS 标准
- 完整的产品系列和 PSpice 模型：

<http://www.infineon.com/igbt/>



应用：

- 工业级不间断电源 (UPS)
- 充电器
- 储能
- 三电平组串太阳能逆变器

产品验证

符合 JEDEC47/20/22 相关测试的工业应用要求



关键性能和封装参数

Type	V_{CE}	I_C	$V_{CE(sat)}, T_{vj}=25^{\circ}\text{C}$	T_{vjmax}	Marking	Package
IKY75N120CH3	1200V	75A	2V	175°C	K75MCH3	PG-TO247-4-2

本数据手册的原文使用英文撰写。为方便起见，英飞凌提供了译文；由于翻译过程中可能使用了自动化工具，英飞凌不保证译文的准确性。为确认准确性，请务必访问 infineon.com 参考最新的英文版本（控制文档）。

第三代高速开关 IGBT 系列

目录

描述.....1

目录 2

最大额定值..... 3

热阻抗..... 3

电气特性..... 4

电气特性图..... 6

封装图编号..... 13

测试条件..... 14

修订记录..... 15

免责声明..... 16

第三代高速开关 IGBT 系列

最大额定值

注意：为了获得最佳的使用寿命和可靠性，英飞凌建议运行条件不超过本数据手册中所述最大额定值的 80%。

Parameter	Symbol	Value	Unit
Collector-emitter voltage, $T_{vj} \geq 25^{\circ}\text{C}$	V_{CE}	1200	V
DC collector current, limited by T_{vjmax} $T_c = 25^{\circ}\text{C}$ $T_c = 134^{\circ}\text{C}$	I_C	150.0 75.0	A
Pulsed collector current, t_p limited by T_{vjmax}	I_{Cpuls}	300.0	A
Turn off safe operating area $V_{CE} \leq 1200\text{V}$, $T_{vj} \leq 175^{\circ}\text{C}$, $t_p = 1\mu\text{s}$	-	300.0	A
Diode forward current, limited by T_{vjmax} $T_c = 25^{\circ}\text{C}$ $T_c = 100^{\circ}\text{C}$	I_F	150.0 75.0	A
Diode pulsed current, t_p limited by T_{vjmax}	I_{Fpuls}	300.0	A
Gate-emitter voltage Transient Gate-emitter voltage ($t_p \leq 10\mu\text{s}$, $D < 0.010$)	V_{GE}	± 20 ± 30	V
Short circuit withstand time $V_{GE} = 15.0\text{V}$, $V_{CC} \leq 600\text{V}$ Allowed number of short circuits < 1000 Time between short circuits: $\geq 1.0\text{s}$ $T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$	t_{SC}	10	μs
Power dissipation $T_c = 25^{\circ}\text{C}$ Power dissipation $T_c = 134^{\circ}\text{C}$	P_{tot}	938.0 256.0	W
Operating junction temperature	T_{vj}	$-40 \dots +175$	$^{\circ}\text{C}$
Storage temperature	T_{stg}	$-55 \dots +150$	$^{\circ}\text{C}$
Soldering temperature, wave soldering 1.6mm (0.063in.) from case for 10s		260	$^{\circ}\text{C}$

热阻抗

Parameter	Symbol	Conditions	Value			Unit
			min.	typ.	max.	

 R_{th} 特性

IGBT thermal resistance, ¹⁾ junction - case	$R_{th(j-c)}$		-	-	0.16	K/W
Diode thermal resistance, ¹⁾ junction - case	$R_{th(j-c)}$		-	-	0.28	K/W
Thermal resistance junction - ambient	$R_{th(j-a)}$		-	-	40	K/W

¹⁾热阻抗 $R_{th(c-s)}$ (外壳到散热器) 大于 0.1K/W 的导热硅脂不包括在内。

第三代高速开关 IGBT 系列

电气特性，测于 $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ 的条件下，除非另有规定

Parameter	Symbol	Conditions	Value			Unit
			min.	typ.	max.	
静态特性						
Collector-emitter breakdown voltage	$V_{(BR)CES}$	$V_{GE} = 0V, I_C = 0.50mA$	1200	-	-	V
Collector-emitter saturation voltage	V_{CESat}	$V_{GE} = 15.0V, I_C = 75.0A$ $T_{vj} = 25^{\circ}C$ $T_{vj} = 175^{\circ}C$	- -	2.00 2.50	2.35 -	V
Diode forward voltage	V_F	$V_{GE} = 0V, I_F = 75.0A$ $T_{vj} = 25^{\circ}C$ $T_{vj} = 175^{\circ}C$	- -	1.90 1.85	2.30 -	V
Gate-emitter threshold voltage	$V_{GE(th)}$	$I_C = 2.60mA, V_{CE} = V_{GE}$	5.1	5.8	6.5	V
Zero gate voltage collector current	I_{CES}	$V_{CE} = 1200V, V_{GE} = 0V$ $T_{vj} = 25^{\circ}C$ $T_{vj} = 175^{\circ}C$	- -	- 5000	450 -	μA
Gate-emitter leakage current	I_{GES}	$V_{CE} = 0V, V_{GE} = 20V$	-	-	100	nA
Transconductance	g_{fs}	$V_{CE} = 20V, I_C = 75.0A$	-	26.0	-	S

电气特性，测于 $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ 的条件下，除非另有规定

Parameter	Symbol	Conditions	Value			Unit
			min.	typ.	max.	
动态特性						
Input capacitance	C_{ies}	$V_{CE} = 25V, V_{GE} = 0V, f = 1MHz$	-	4856	-	pF
Output capacitance	C_{oes}		-	505	-	
Reverse transfer capacitance	C_{res}		-	290	-	
Gate charge	Q_G	$V_{CC} = 960V, I_C = 75.0A,$ $V_{GE} = 15V$	-	370.0	-	nC
Internal emitter inductance measured 5mm (0.197 in.) from case	L_E		-	13.0	-	nH

开关特性、感性负载

Parameter	Symbol	Conditions	Value			Unit
			min.	typ.	max.	

IGBT 特性，测于 $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ 的条件下

Turn-on delay time	$t_{d(on)}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C},$ $V_{CC} = 600\text{V}, I_C = 75.0\text{A},$ $V_{GE} = 0.0/15.0\text{V},$ $R_{G(on)} = 6.0\Omega, R_{G(off)} = 6.0\Omega,$ $L\sigma = 70\text{nH}, C\sigma = 67\text{pF}$ $L\sigma, C\sigma$ from Fig. E Energy losses include "tail" and diode reverse recovery.	-	38	-	ns
Rise time	t_r		-	32	-	ns
Turn-off delay time	$t_{d(off)}$		-	303	-	ns
Fall time	t_f		-	32	-	ns
Turn-on energy	E_{on}		-	3.40	-	mJ
Turn-off energy	E_{off}		-	2.90	-	mJ
Total switching energy	E_{ts}		-	6.30	-	mJ

第三代高速开关 IGBT 系列

二极管特性, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$

Diode reverse recovery time	t_{rr}	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C},$ $V_R = 600\text{V}, I_F$ $= 75.0\text{A},$ $di_F/dt = 1200\text{A}/\mu\text{s}$	-	292	-	ns
Diode reverse recovery charge	Q_{rr}		-	4.90	-	μC
Diode peak reverse recovery current	I_{rrm}		-	41.0	-	A
Diode peak rate of fall of reverse recovery current during t_b	di_{rr}/dt		-	-585	-	$\text{A}/\mu\text{s}$

开关特性、感性负载

Parameter	Symbol	Conditions	Value			Unit
			min.	typ.	max.	

IGBT 特性, 测于 $T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$ 的条件

Turn-on delay time	$t_{d(on)}$	$T_{vj} = 175^{\circ}\text{C},$ $V_{CC} = 600\text{V}, I_C = 75.0\text{A},$ $V_{GE} = 0.0/15.0\text{V},$ $R_{G(on)} = 6.0\Omega, R_{G(off)} = 6.0\Omega,$ $L\sigma = 70\text{nH}, C\sigma = 67\text{pF}$ $L\sigma, C\sigma$ from Fig. E Energy losses include "tail" and diode reverse recovery.	-	38	-	ns
Rise time	t_r		-	35	-	ns
Turn-off delay time	$t_{d(off)}$		-	400	-	ns
Fall time	t_f		-	68	-	ns
Turn-on energy	E_{on}		-	6.10	-	mJ
Turn-off energy	E_{off}		-	6.00	-	mJ
Total switching energy	E_{ts}		-	12.10	-	mJ

二极管特性, 测于 $T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$ 的条件下

Diode reverse recovery time	t_{rr}	$T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}, V_R$ $= 600\text{V}, I_F =$ $75.0\text{A},$ $di_F/dt = 1200\text{A}/\mu\text{s}$	-	538	-	ns
Diode reverse recovery charge	Q_{rr}		-	13.80	-	μC
Diode peak reverse recovery current	I_{rrm}		-	60.0	-	A
Diode peak rate of fall of reverse recovery current during t_b	di_{rr}/dt		-	-360	-	$\text{A}/\mu\text{s}$

第三代高速开关 IGBT 系列

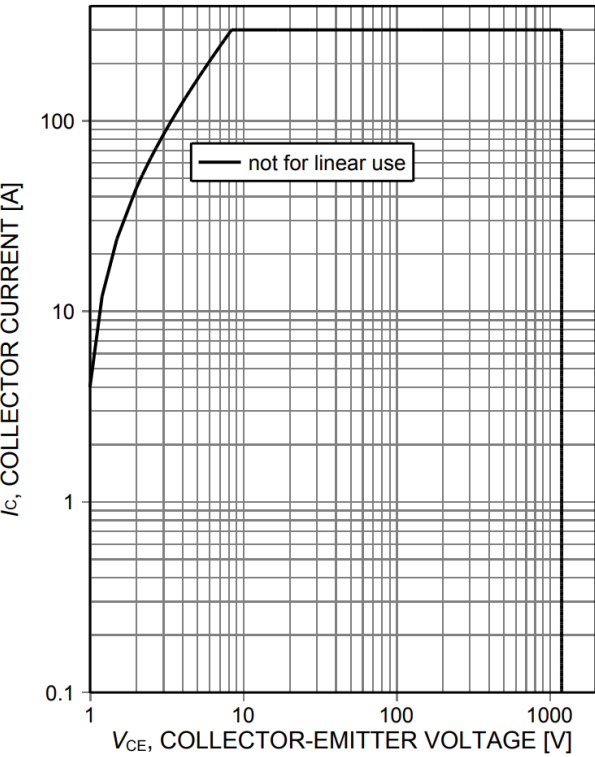


Figure 1. **Forward bias safe operating area**
($D=0$, $T_C=25^{\circ}\text{C}$, $T_{vj}\leq 175^{\circ}\text{C}$; $V_{GE}=15\text{V}$)

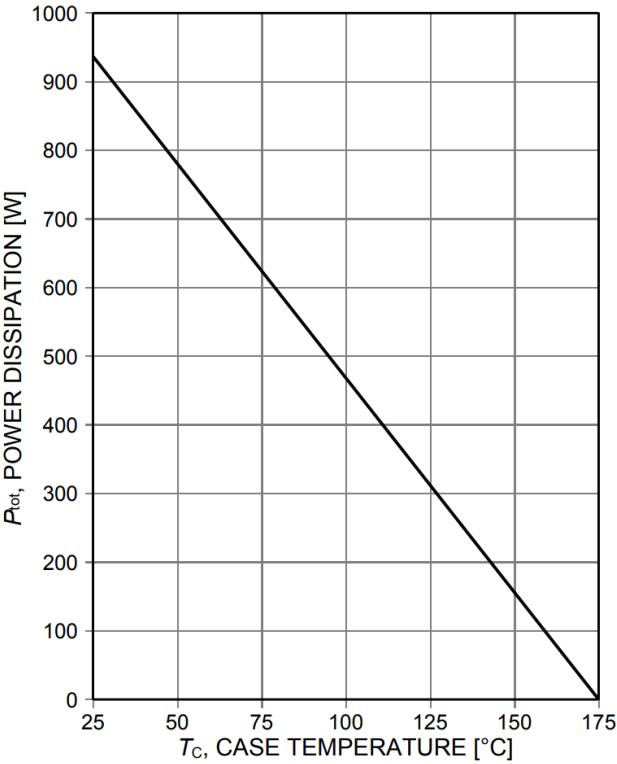


Figure 2. **Power dissipation as a function of case temperature**
($T_{vj}\leq 175^{\circ}\text{C}$)

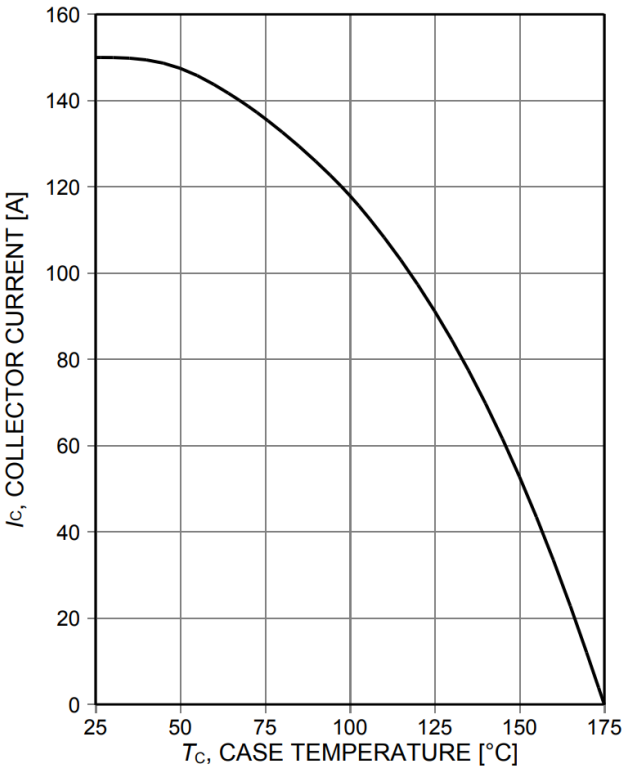


Figure 3. **Collector current as a function of case temperature**
($V_{GE}\geq 15\text{V}$, $T_{vj}\leq 175^{\circ}\text{C}$)

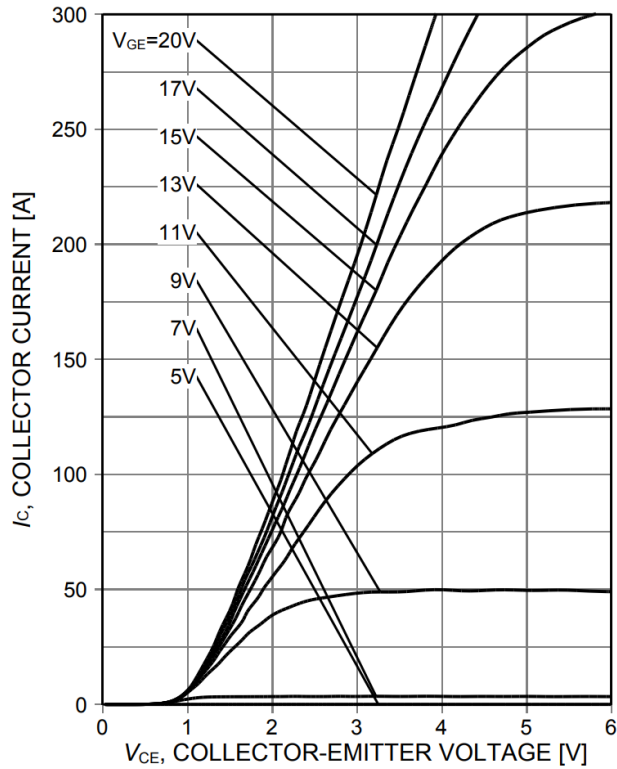


Figure 4. **Typical output characteristic**
($T_{vj}=25^{\circ}\text{C}$)

第三代高速开关 IGBT 系列

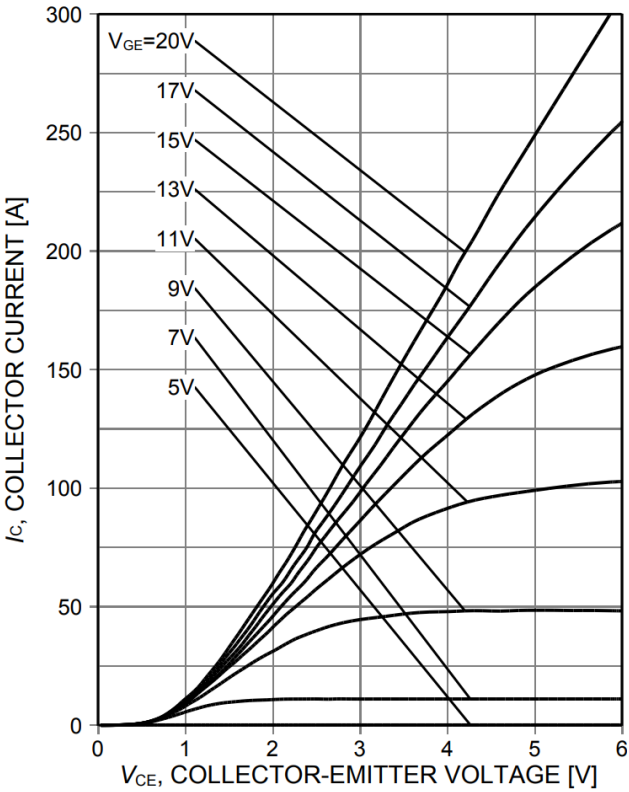


Figure 5. Typical output characteristic ($T_{vj}=175^{\circ}\text{C}$)

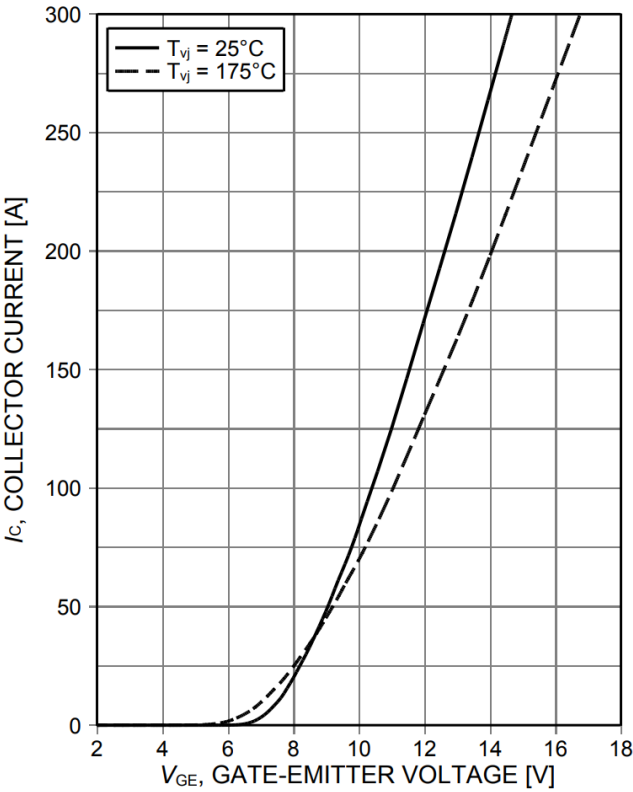


Figure 6. Typical transfer characteristic ($V_{ce}=20\text{V}$)

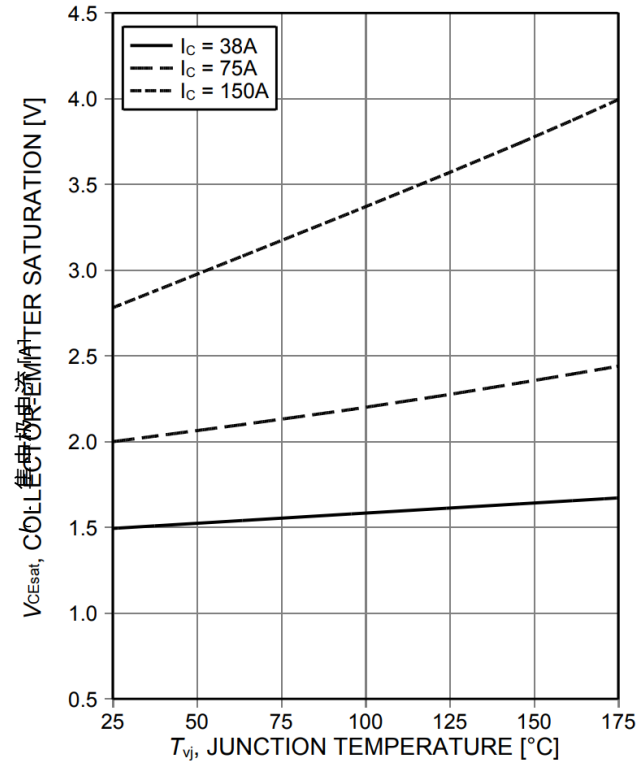


Figure 7. Typical collector-emitter saturation voltage as a function of junction temperature ($V_{ge}=15\text{V}$)

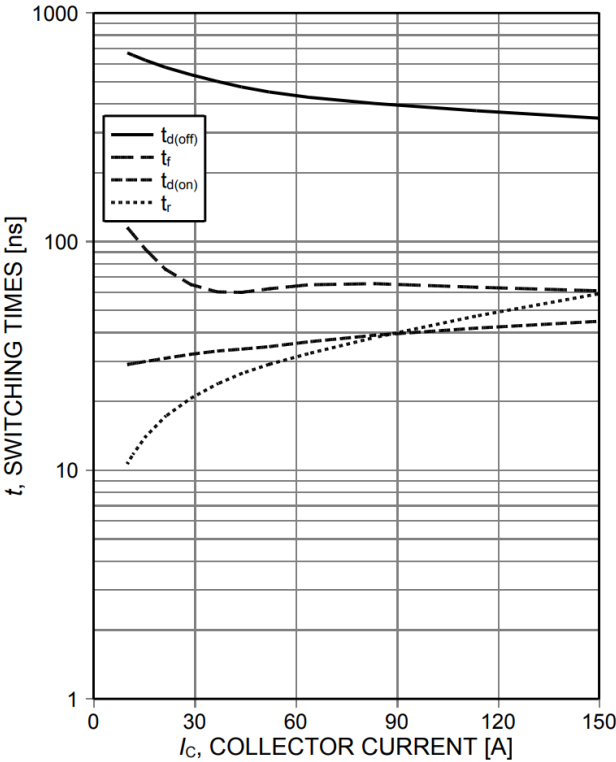


Figure 8. Typical switching times as a function of collector current (inductive load, $T_{vj}=175^{\circ}\text{C}$, $V_{ce}=600\text{V}$, $V_{ge}=0/15\text{V}$, $R_G=6\Omega$, Dynamic test circuit in Figure E)

第三代高速开关 IGBT 系列

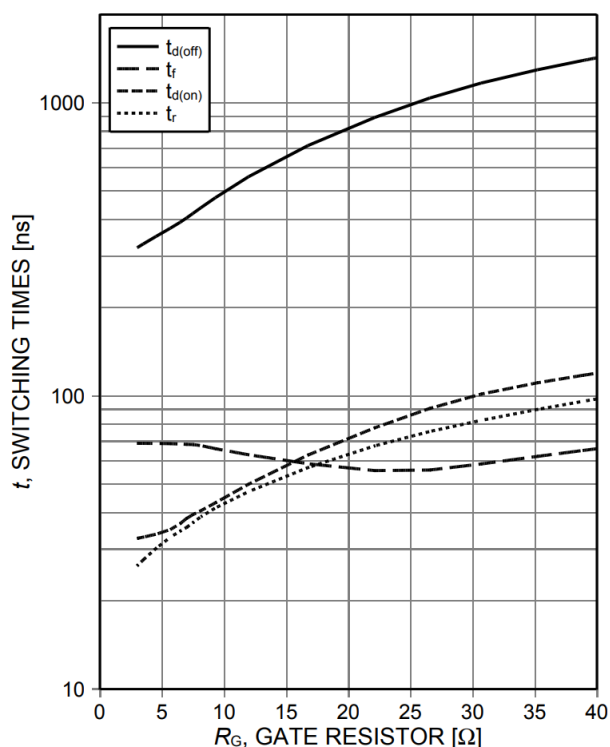


Figure 9. **Typical switching times as a function of gate resistor**
(inductive load, $T_{vj}=175^{\circ}\text{C}$, $V_{CE}=600\text{V}$, $V_{GE}=0/15\text{V}$, $I_C=75\text{A}$, Dynamic test circuit in Figure E)

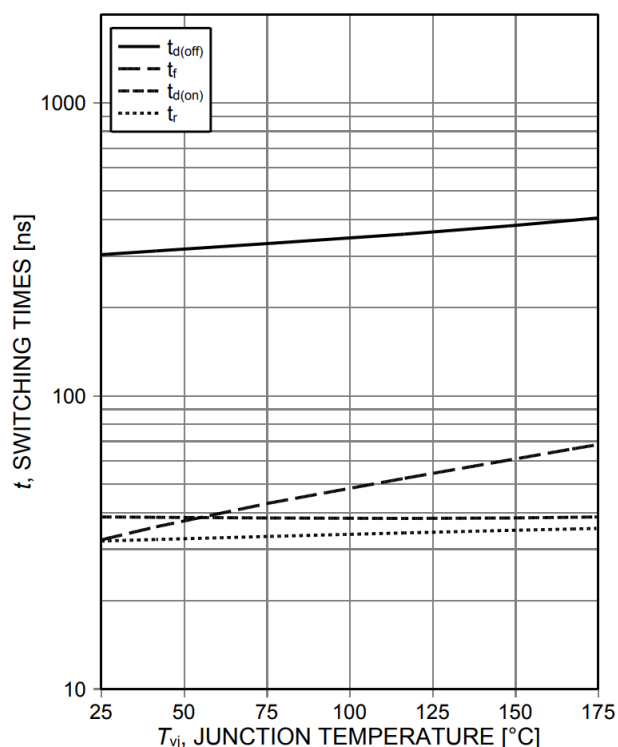


Figure 10. **Typical switching times as a function of junction temperature**
(inductive load, $V_{CE}=600\text{V}$, $V_{GE}=0/15\text{V}$, $I_C=75\text{A}$, $R_G=6\Omega$, Dynamic test circuit in Figure E)

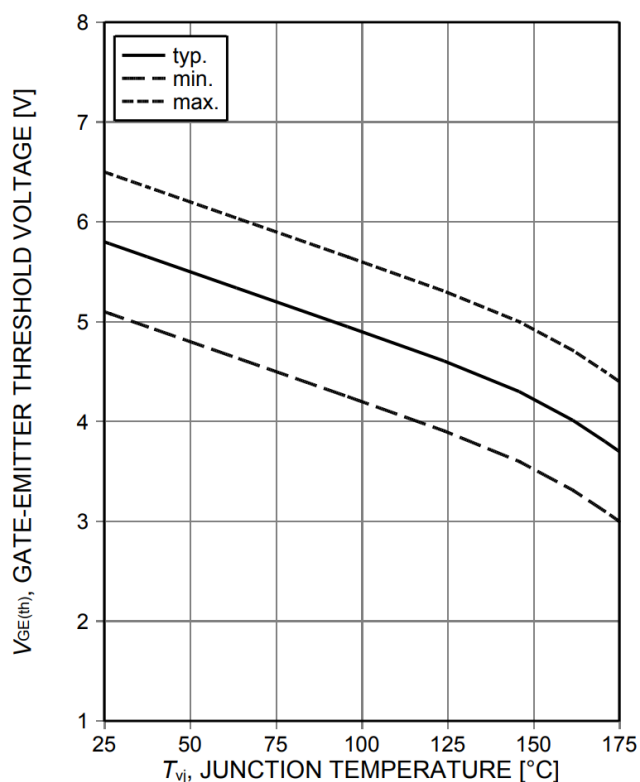


Figure 11. **Gate-emitter threshold voltage as a function of junction temperature**
($I_C=2.6\text{mA}$)

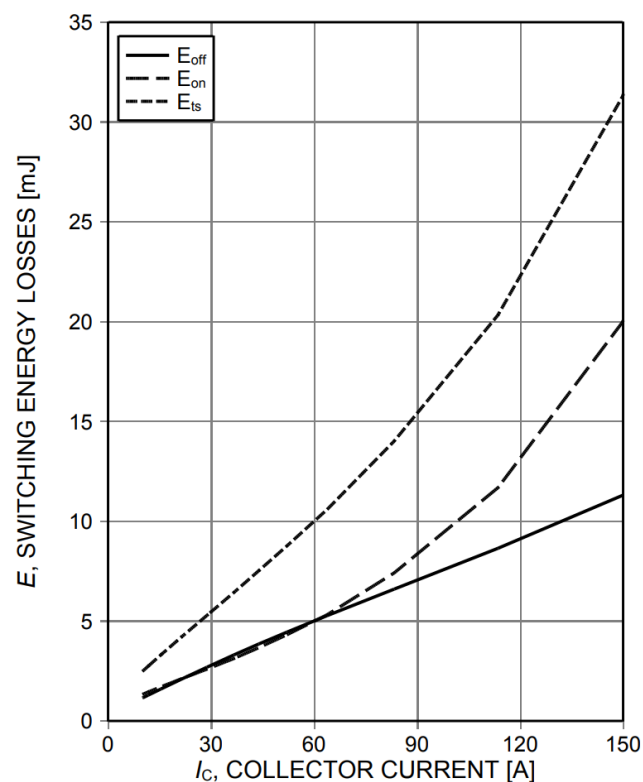


Figure 12. **Typical switching energy losses as a function of collector current**
(inductive load, $T_{vj}=175^{\circ}\text{C}$, $V_{CE}=600\text{V}$, $V_{GE}=0/15\text{V}$, $R_G=6\Omega$, Dynamic test circuit in Figure E)

第三代高速开关 IGBT 系列

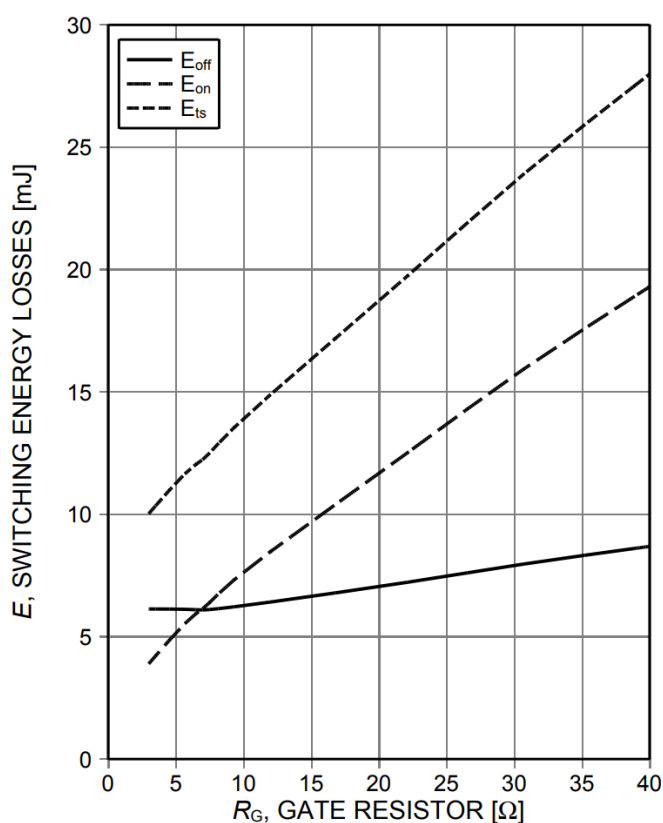


Figure 13. **Typical switching energy losses as a function of gate resistor**
(inductive load, $T_{vj}=175^{\circ}\text{C}$, $V_{CE}=600\text{V}$, $V_{GE}=0/15\text{V}$, $I_C=75\text{A}$, Dynamic test circuit in Figure E)

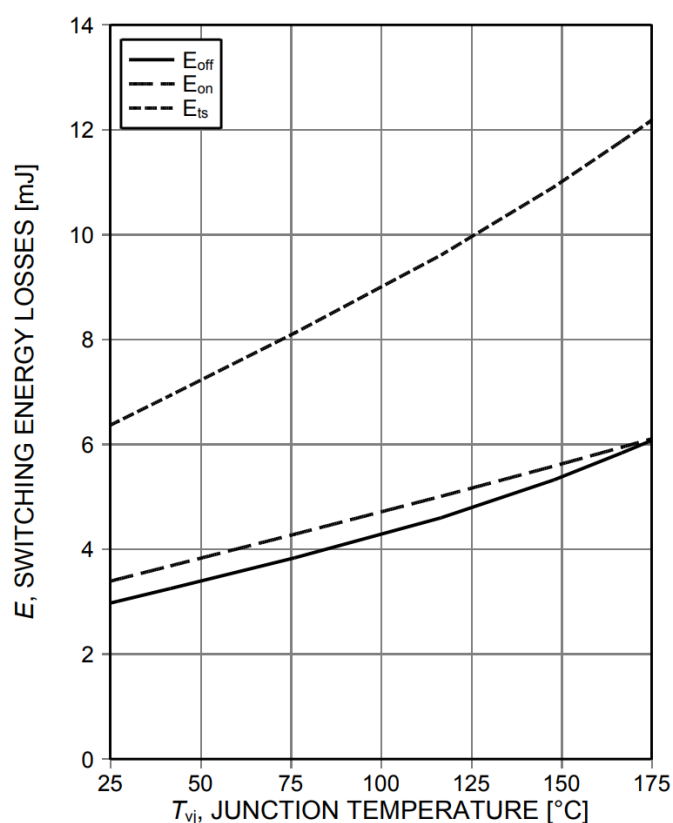


Figure 14. **Typical switching energy losses as a function of junction temperature**
(inductive load, $V_{CE}=600\text{V}$, $V_{GE}=0/15\text{V}$, $I_C=75\text{A}$, $R_G=6\Omega$, Dynamic test circuit in Figure E)

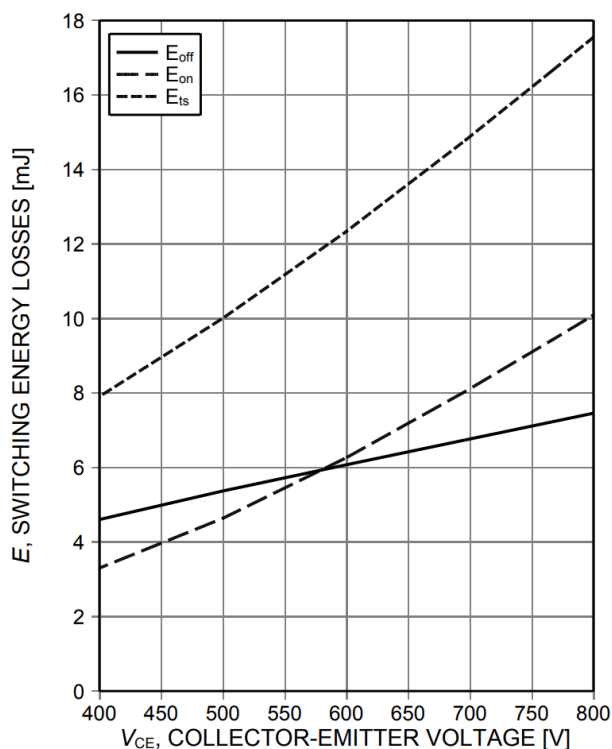


Figure 15. **Typical switching energy losses as a function of collector emitter voltage**
(inductive load, $T_{vj}=175^{\circ}\text{C}$, $V_{GE}=0/15\text{V}$, $I_C=75\text{A}$, $R_G=6\Omega$, Dynamic test circuit in Figure E)

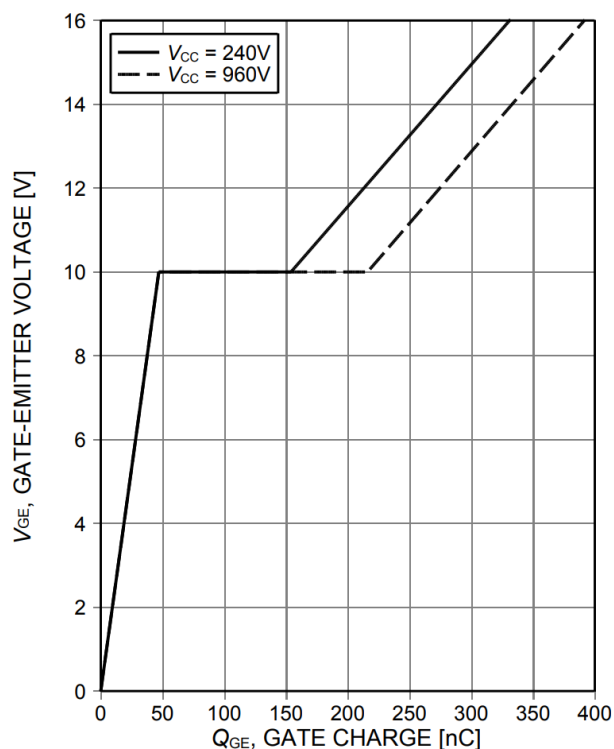


Figure 16. **Typical gate charge**
($I_C=75\text{A}$)

第三代高速开关 IGBT 系列

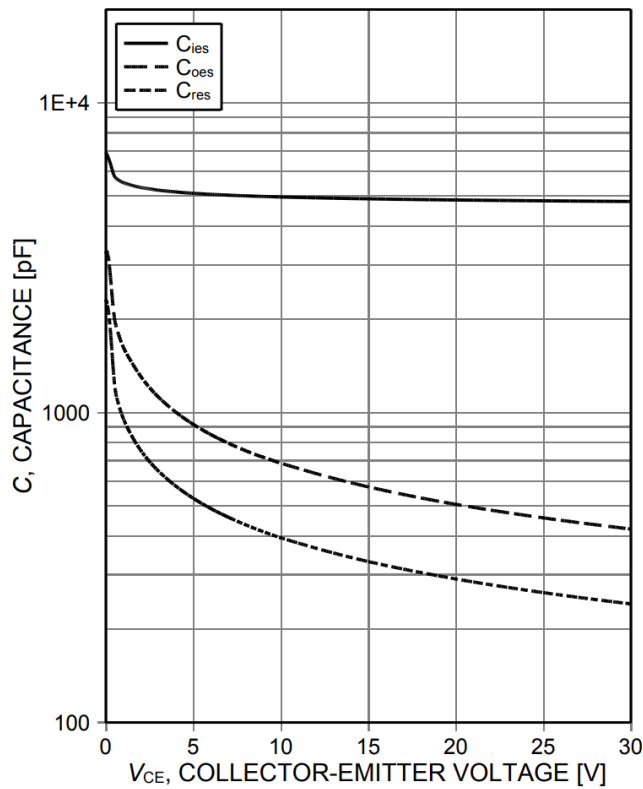


Figure 17. Typical capacitance as a function of collector-emitter voltage ($V_{GE}=0V$, $f=1MHz$)

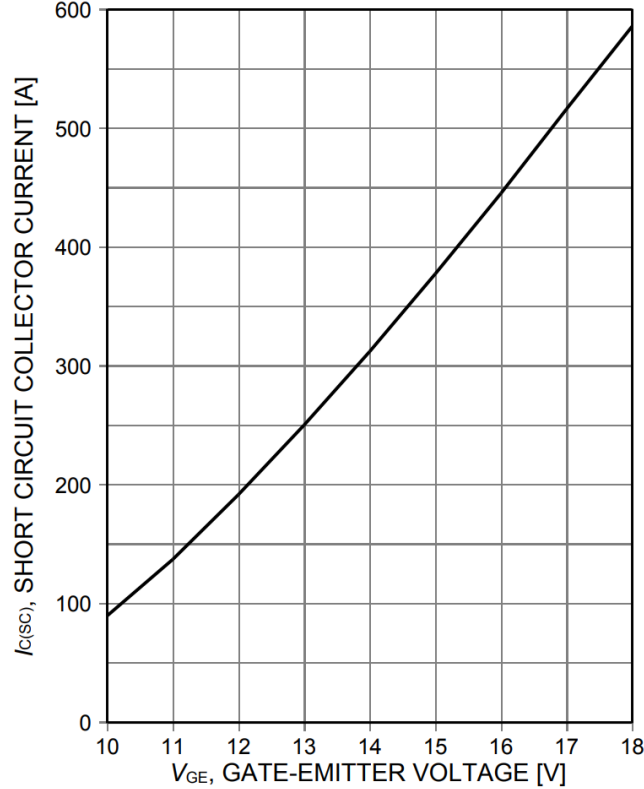


Figure 18. Typical short circuit collector current as a function of gate-emitter voltage ($V_{CE}\leq 600V$, $T_{vj}\leq 175^{\circ}C$)

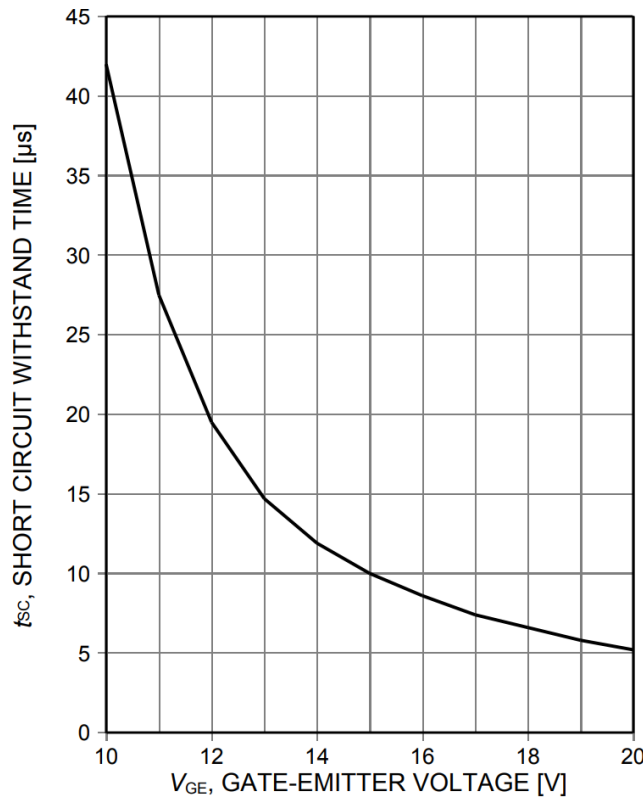


Figure 19. Short circuit withstand time as a function of gate-emitter voltage ($V_{CE}\leq 600V$, start at $T_{vj}\leq 175^{\circ}C$)

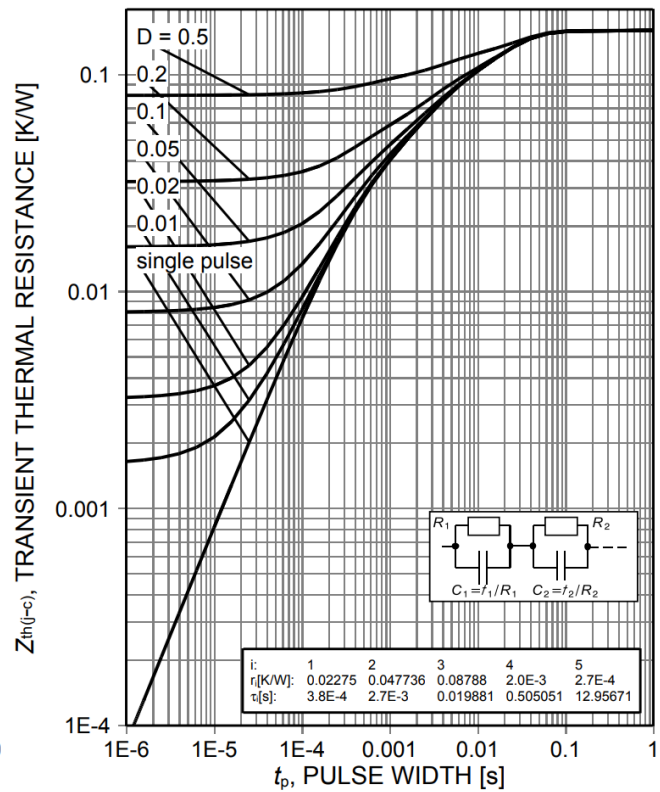


Figure 20. IGBT transient thermal resistance ($D=t_p/T$)

第三代高速开关 IGBT 系列

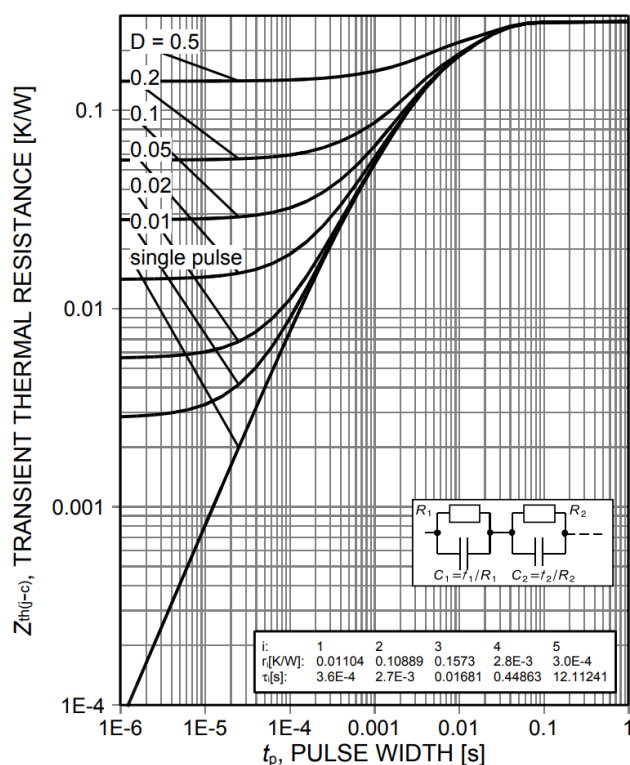


Figure 21. Diode transient thermal impedance as a function of pulse width ($D=t_p/T$)

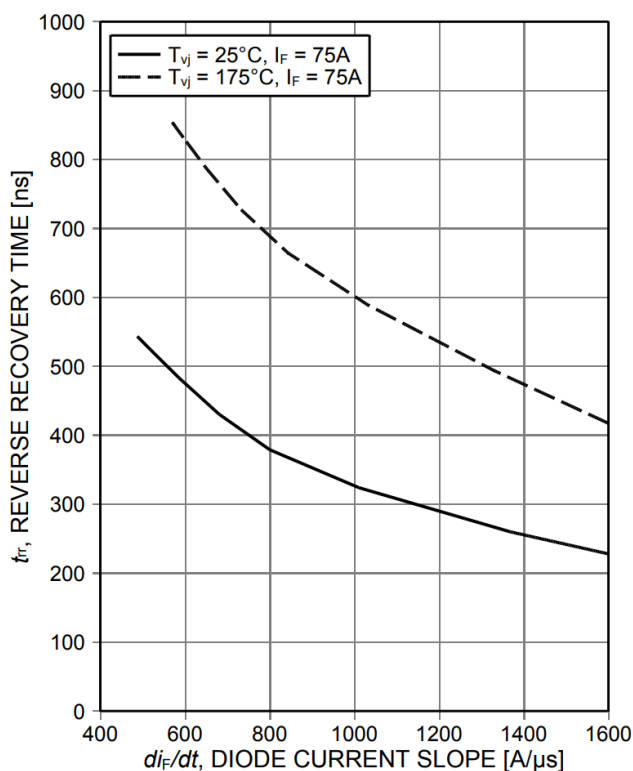


Figure 22. Typical reverse recovery time as a function of diode current slope ($V_R=600V$)

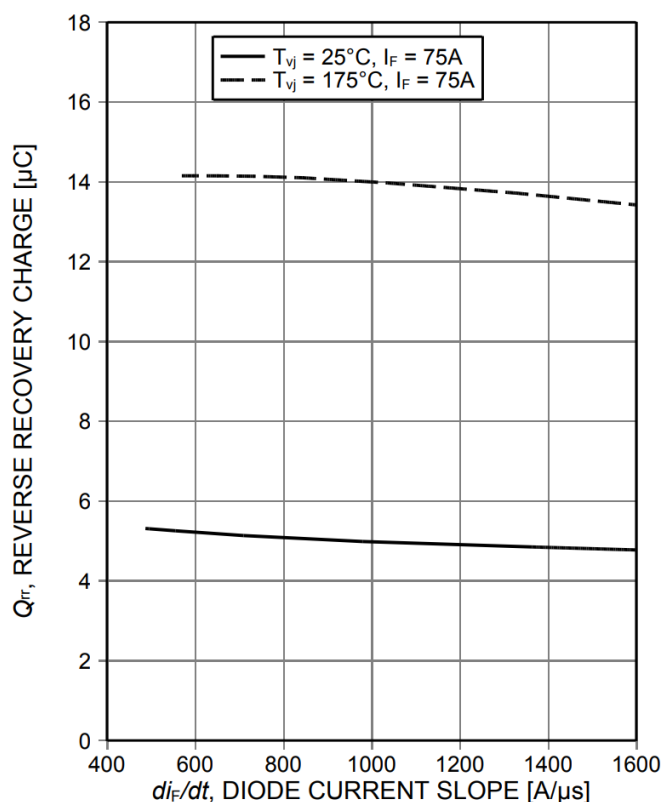


Figure 23. Typical reverse recovery charge as a function of diode current slope ($V_R=600V$)

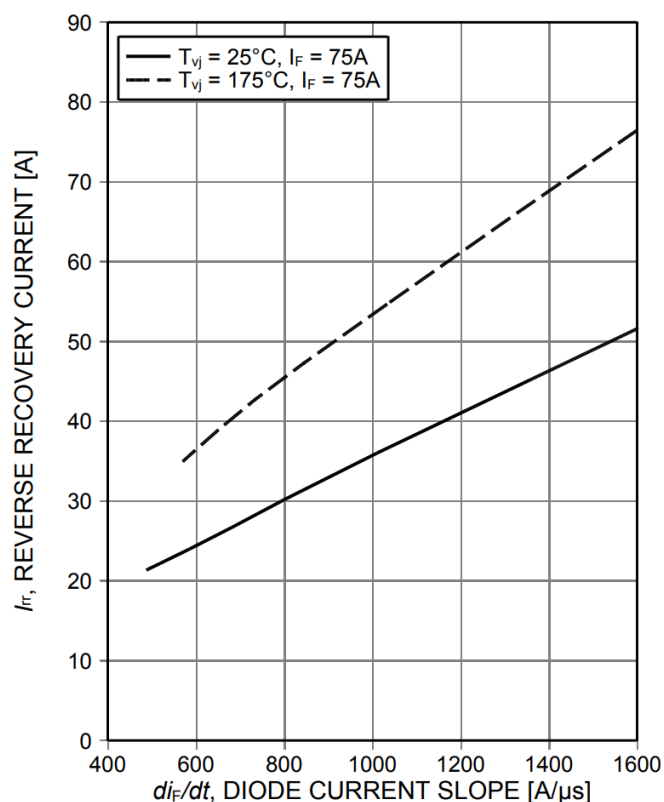


Figure 24. Typical reverse recovery current as a function of diode current slope ($V_R=600V$)

第三代高速开关 IGBT 系列

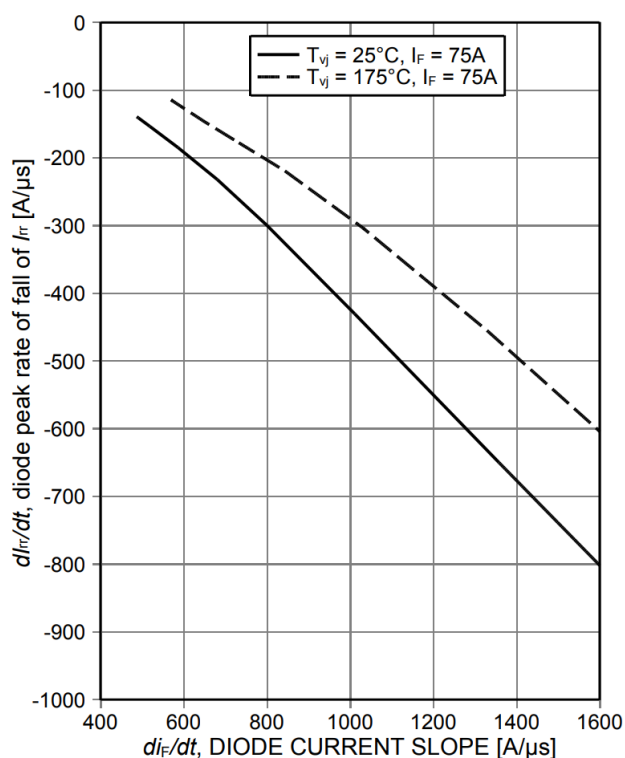


Figure 25. **Typical diode peak rate of fall of reverse recovery current as a function of diode current slope**
($V_R=600V$)

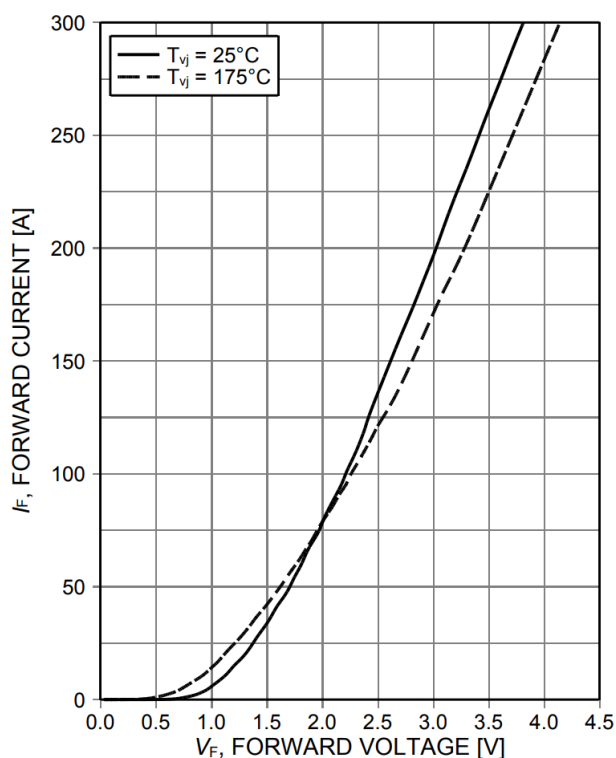


Figure 26. **Typical diode forward current as a function of forward voltage**

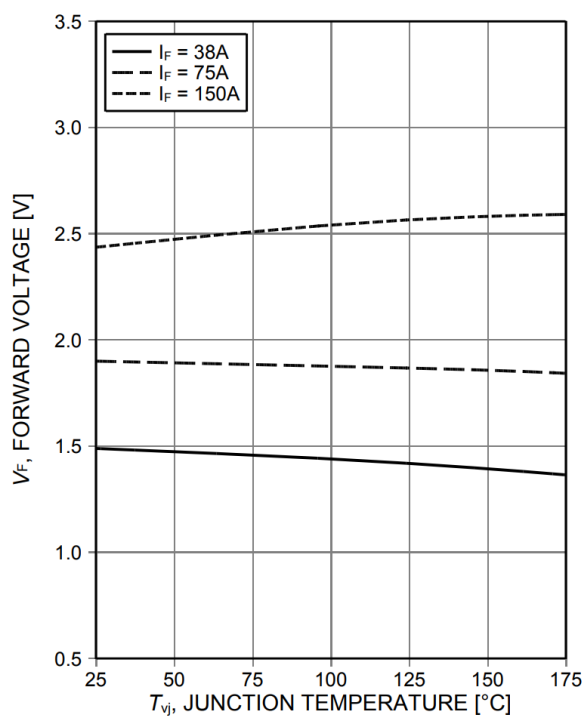
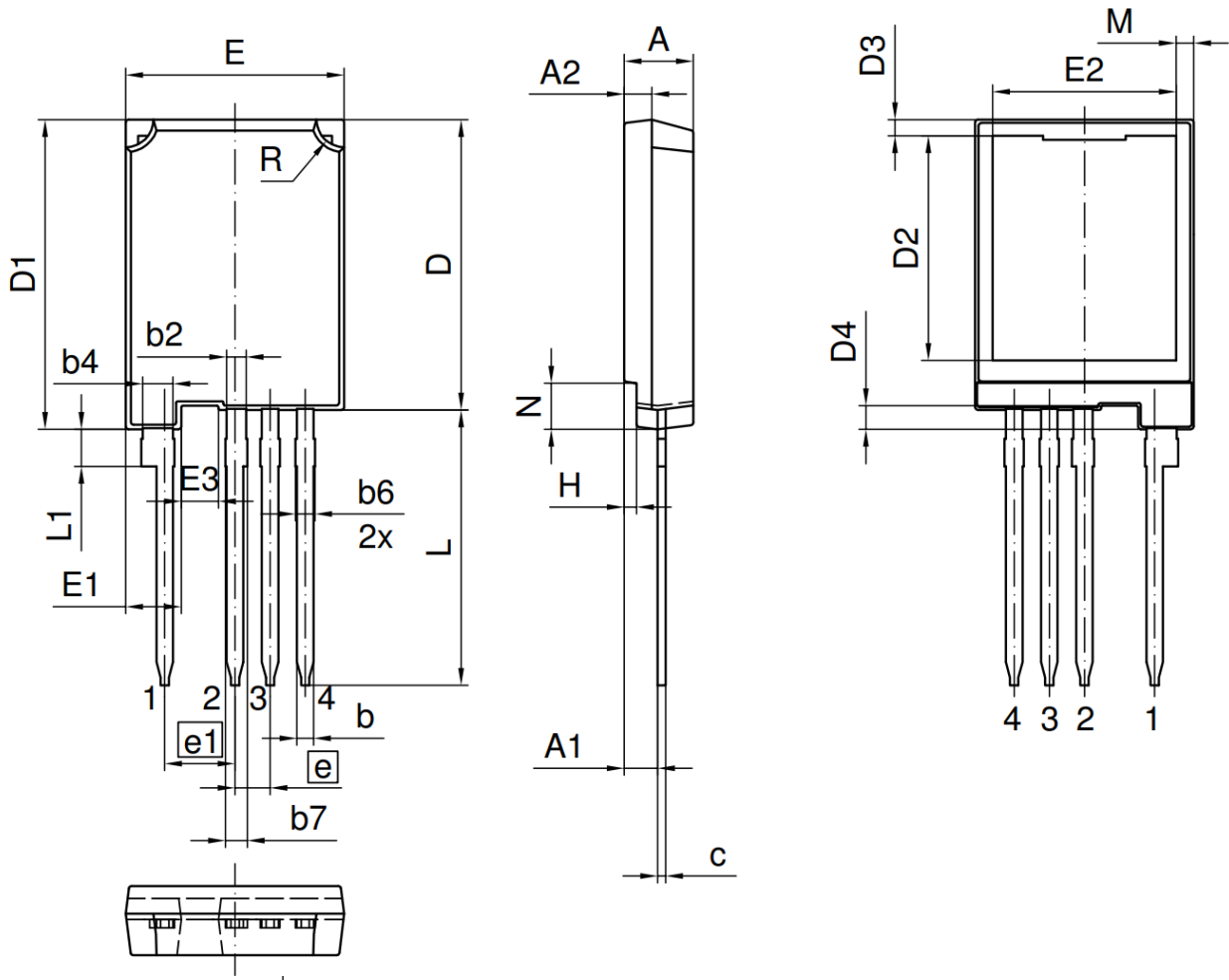


Figure 27. **Typical diode forward voltage as a function of junction temperature**

PG-TO247-4-2



NOTES:
PACKAGE SURFACE ROUTE BETWEEN
PIN 1 & PIN 2 WILL BE 5.1mm MIN.

ALL b... AND c DIMENSIONS INCLUDING
PLATING EXCEPT AREA OF CUTTING

DIMENSION	MILLIMETERS	
	MIN.	MAX.
A	4.9	5.1
A1	2.31	2.51
A2	1.9	2.1
b	1.16	1.29
b2	1.36	1.49
b4	2.16	2.29
b6	1.16	1.45
b7	1.16	1.65
c	0.59	0.66
D	20.9	21.1
D1	22.3	22.5
D2	15.95	16.55
D3	1	1.35
D4	1.6	1.8
E	15.7	15.9
E1	3.9	4.1
E2	13.1	13.5
E3	2.58	2.78
e	2.54	
e1	5.08	
H	0.8	1
L	19.8	20.1
L1	2.55	2.85
M	0.97	1.57
N	3.24	3.44
R	1.9	2.1

DOCUMENT NO.
Z8B00182798

REVISION
01

SCALE 2:1

EUROPEAN PROJECTION

ISSUE DATE
23.09.2016

第三代高速开关 IGBT 系列

测试条件

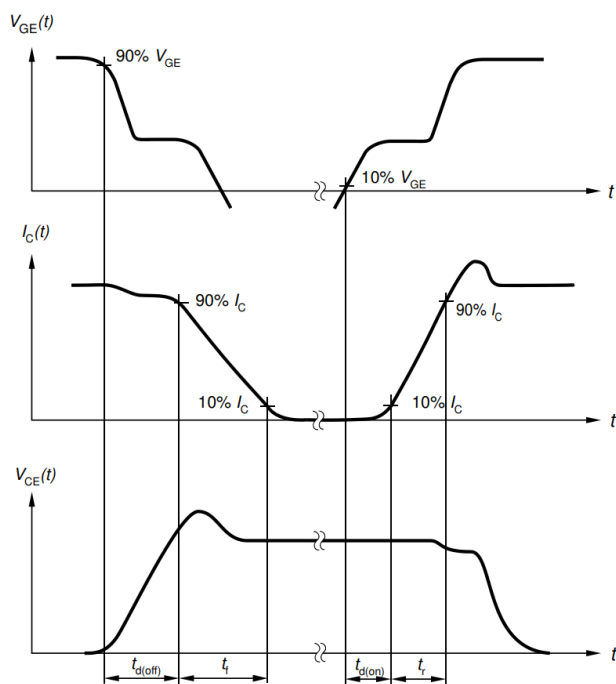


Figure A. Definition of switching times

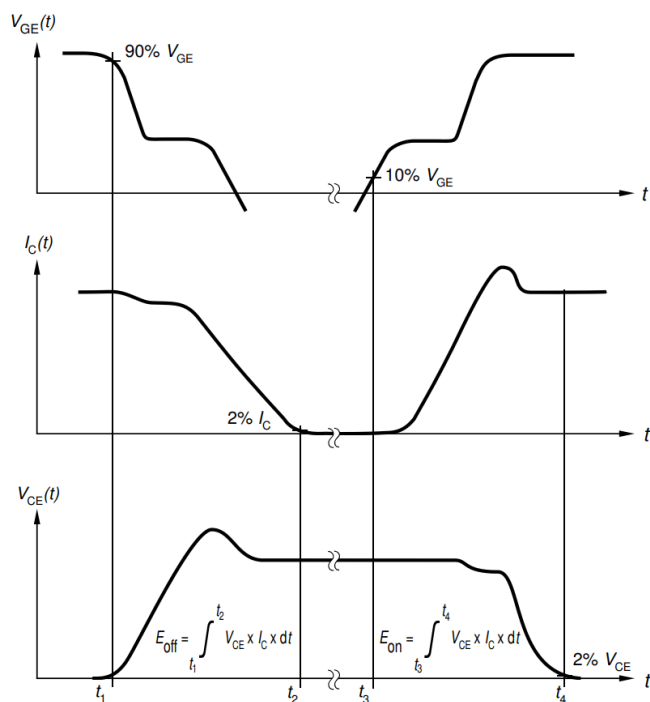


Figure B. Definition of switching losses

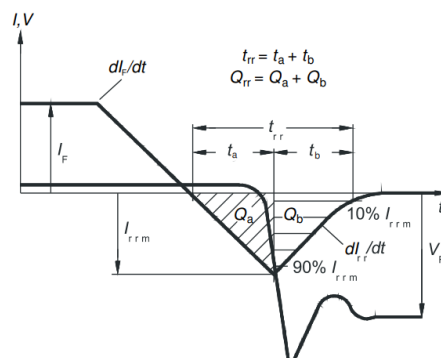


Figure C. Definition of diode switching characteristics

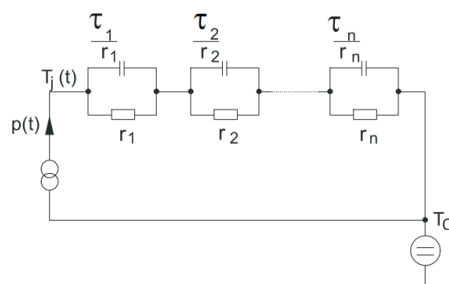


Figure D. Thermal equivalent circuit

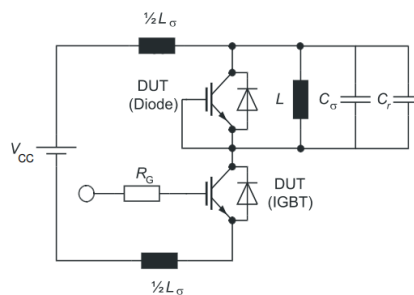


Figure E. Dynamic test circuit
Parasitic inductance L_σ ,
parasitic capacitor C_σ ,
relief capacitor C_r ,
(only for ZVT switching)

第三代高速开关 IGBT 系列

修订记录

IKY75N120CH3**Revision: 2019-04-15, Rev. 2.3**

历史修订版本

Revision	Date	Subjects (major changes since last revision)
2.1	2017-04-26	Final data sheet
2.2	2017-06-09	Update Figure 6
2.3	2019-04-15	Update condition for V _{geth} page 4 and Fig. 11



免责声明

请注意，本文件的原文使用英文撰写，为方便客户浏览英飞凌提供了中文译文。该中文译文仅供参考，并不可作为任何论点之依据。

由于翻译过程中可能使用了自动化程序，以及语言翻译和转换过程中的差异，最后的中文译文与最新的英文版本原文含义可能存在不尽相同之处。

因此，我们同时提供该中文译文版本的最新英文原文供您阅读，请参见 <http://www.infineon.com>

英文原文和中文译文版本之间若存有任何歧异，以最新的英文版本为准，并且仅认可英文版本为正式文件。

您如果使用本文件，即表示您同意并理解上述说明。英飞凌不对因翻译过程中可能存在的任何不完整或不准确信息而产生的任何直接或间接损失或损害负责。英飞凌不承担中文译文版本的完整性和准确性责任。如果您不同意上述说明，请不要使用本文件。

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

重要通知

版本 2025-09-16

Infineon Technologies AG 出版，
德国 Neubiberg 85579

版权 © 2025 Infineon Technologies AG
及其关联公司。
保留所有权利。

Do you have a question about this
document?

Email:
erratum@infineon.com

Infineon Technologies AG 及其关联公司（以下简称“英飞凌”）销售或提供和交付的产品（可能也包括样品，且可能由硬件或软件或两者组成）（以下简称“产品”），应遵守客户与英飞凌签订的框架供应合同或其他书面协议的条款和条件，如无上述合同或其他书面协议，则应遵守适用的英飞凌销售条件。只有在英飞凌明确书面同意的情况下，客户的一般条款和条件或对适用的英飞凌销售条件的偏离才对英飞凌具有约束力。

为避免疑义，英飞凌不承担侵犯第三方权利的所有保证和默示保证，例如对特定用途/目的的适用性或适销性的保证。

英飞凌对与样品、应用或客户对任何产品的具体使用有关的任何信息或本文件中给出的任何示例或典型值概不负责。

本文件中包含的数据仅供具有技术资格和技能的客户代表使用。客户有责任评估产品对预期应用和客户特定用途的适用性，并在预期应用和客户特定用途中验证本文件中包含的所有相关技术数据。客户有责任正确设计、编程和测试预期应用的功能性和安全性，并遵守与其使用相关的法律要求。

除非英飞凌另行明确批准，否则产品不得用于任何因产品故障或使用产品的任何后果可合理预期会导致人身伤害的应用。但是，上述规定并不妨碍客户在英飞凌明确设计和销售的使用领域中使用任何产品，但是客户对应用负有全部责任。

英飞凌明确保留根据适用法律，如《德国版权法》（UrhG）第 44b 条，将其内容用于商业资料和数据勘探（TDM）的权利。

如果产品包含安全功能：

由于任何计算设备都不可能绝对安全，尽管产品采取了安全措施，但英飞凌不保证产品不会被入侵、数据不会被盗或遗失，或不会发生其他漏洞（以下简称“安全漏洞”），英飞凌对任何安全漏洞不承担任何责任。

如果本文件包含或引用软件：

根据美国、德国和世界其他国家的知识产权法律和条约，该软件归英飞凌所有。英飞凌保留所有权利。因此，您只能按照软件附带的软件授权协议的规定使用本软件。

如果没有适用的软件授权协议，英飞凌特此授予您个人的、非排他性的、不可转让的软件知识产权授权（无权转授权）：(a) 对于以源代码形式提供的软件，仅在贵组织内部修改和复制该软件用于英飞凌硬件产品；及 (b) 对于以二进制代码 (binary code) 形式对外向终端用户分发该软件，仅得用于英飞凌硬件产品。禁止对本软件进行任何其他使用、复制、修改、翻译或编译。有关产品、技术、交货条款和条件以及价格的详细信息，请联系离您最近的英飞凌办公室或访问 <https://www.infineon.com>。